

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2012 年 9 月 13 日(13.09.2012)



(10) 国際公開番号
WO 2012/121164 A1

- (51) 国際特許分類:
C08L 79/08 (2006.01) *C08K 3/00* (2006.01)
B32B 15/088 (2006.01) *C08L 101/00* (2006.01)
C08G 73/10 (2006.01) *H01L 23/14* (2006.01)
C08J 5/24 (2006.01) *H05K 1/03* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2012/055435
- (22) 国際出願日: 2012 年 3 月 2 日(02.03.2012)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2011-049423 2011 年 3 月 7 日(07.03.2011) JP
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 三菱瓦斯化学株式会社 (Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.) [JP/JP]; 〒1008324 東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 2 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 大森 貴文 (OOMORI, Takabumi) [JP/JP]; 〒9618031 福島県西白河郡西郷村米字楢山 9 番 4 1 号エレクトロテクノ株式会社内 Fukushima (JP). 長谷部 恵一 (HASEBE, Keiichi) [JP/JP]; 〒1258601 東京都葛飾区

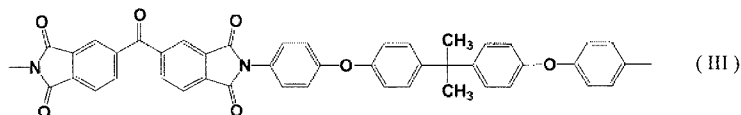
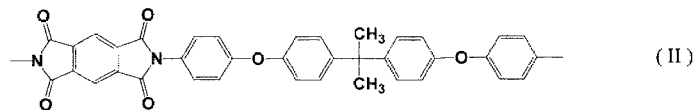
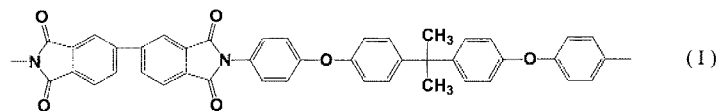
新宿 6 丁目 1 番 1 号三菱瓦斯化学株式会社東京テクノパーク内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 青木 篤, 外(AOKI, Atsushi et al.); 〒1058423 東京都港区虎ノ門三丁目 5 番 1 号 虎ノ門 3 7 森ビル青和特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR),

[続葉有]

(54) Title: RESIN COMPOSITION FOR PRINTED CIRCUIT BOARD

(54) 発明の名称: プリント配線板用樹脂組成物



(57) Abstract: Provided is a resin composition comprising a polyimide resin, a thermosetting resin, and a filler, wherein the polyimide resin comprises first repeating units represented by formula (I) and second repeating units represented by formula (II) or (III); when the second repeating units are represented by formula (II), the percentage of second repeating units per total polyimide resin is 5 to 35 mol%; and when the second repeating units are represented by formula (III), the percentage of second repeating units per total polyimide resin is 5 to 80 mol%.

(57) 要約: ポリイミド樹脂、熱硬化性樹脂、および充填材を含んでなる樹脂組成物であって、前記ポリイミド樹脂が、下記式 (I) で表される第 1 の繰り返し単位と、下記式 (II) または (III) で表される第 2 の繰り返し単位とを含んでなり、第 2 の繰り返し単位が下記式 (II) で表される場合、ポリイミド樹脂全体に対する第 2 の繰り返し単位の比率が 5 ~ 35 モル%であり、第 2 の繰り返し単位が下記式 (III) で表される場合、ポリイミド樹脂全体に対する第 2 の繰り返し単位の比率が 5 ~ 80 モル%である。